

물성분석 / 패키징 단가표

분석분야	분 석 내 용	단가(원)
○ SEM	Gold/PT코팅 및 시료 전처리 별도	60,000
○ 본딩	Die or Wire 본딩 기본	46,000

분석분야	분 석 내 용	단가(원)
시료제작	○Si 재료의 단순 단면시료	240,000
	○화합물 반도체 시료의 단순 단면시료	300,000
	○추가 : 특정 부위 관찰용 시료	107,000
	○SEM/AES/ESCA 관찰용 단면시료	90,000
SEM	○SEM image 관찰	60,000
	- Gold / PT코팅시(1회 : 3개시료)	10,000
	○매 30분 추가 관찰시	44,000
	○추가 image 1개당	3,000
	○동일시료, 다른 부위 관찰(1시 야 당)	17,000
	- 매 30분 추가 관찰시	44,000
	○EDS 정성분석	27,000
	○EDS 정량분석 (5원소 이하)	17,000
본딩	- 본딩 : 기본	46,000